

## 全数保証(不良品ゼロ)実現に向けた インプロセス及びポストプロセス技術の動向

プロダクトライフサイクルの短期化による経営効率からの要請、労働人口の減少などによる労働環境への対応、そして、EV化の進行により自動車がかかわる工業製品になることで、品質管理に求められる基準がPPMオーダの不良品を許容する品質保証から不良品ゼロを求める品質保証に変化している。

今回の講演会は、どのような方法を使って全数保証を行おうとしているのか、インプロセス及びポストプロセスにおける各社の最新技術動向を紹介する。

主 催：公益社団法人砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会  
日 時：2020年10月23日(金) 13:00~17:00  
会 場：Cisco Webex Meeting を用いてオンライン開催します。



13:00~13:05 開会挨拶

池野 順一 委員長

13:05~13:55 <講演1> 「自動運転時代の不良流出リスクに備えた寸法検査の全数検査化」

オムロン株式会社 古川 達也 氏

13:55~14:45 <講演2> 「検査の自動化と高速化に向けた最新の光干渉計測の紹介」

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 佐藤 慶一 氏

14:45~15:05 <休憩>

15:05~15:55 <講演3> 「AIによる加工品質の状態推定」

株式会社富士通研究所 渡部 勇 氏

15:55~16:45 <講演4> 「真円度測定機、形状粗さ測定機を用いた多数個、自動測定の試み」

アメテック株式会社 財満 啓彰 氏

16:45~16:50 閉会挨拶・事務連絡

池野 順一 委員長

参加費：次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会会員：5名まで無料、非会員：15,000円(1社当り2名まで参加)

ただし、Webシステムの契約上、PC接続数は100台までとなっております。当面はPC1台/社に制限させていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

申込締切日：**2020年10月19日(月)** 接続数に限りがございますので早めにお申し込み下さい。

(注) 申込頂いた方で当日不参加の場合は参加費を請求させていただきますのでご了承ください

なお、SF会員の皆様も必ず参加申込み手続きをお願いします。

※申し込み用紙はこちら→<http://spe.mech.saitama-u.ac.jp/mysite5/application2020Web.pdf>

問合せ/申込先：当専門委員会事務局 田附宙美 宛

FAX：048-829-7046, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp